

公益社団法人 砥粒加工学会
砥粒加工工具を考える専門委員会 第2回研究会のご案内
「生き残りをかけた代替加工技術（切断技術の最前線）」

2017 年 6 月、砥粒加工技術の発展のために（公社）砥粒加工学会「砥粒加工工具を考える専門委員会」が設立されました。本専門委員会では、工作物に直接関与する砥粒加工工具について新規開発、問題解決等に関する調査、討論を取り込んでおります。第2回研究会では【生き残りをかけた代替加工技術（切断技術の最前線）】と題して開催いたします。半導体結晶材料等の切断技術に着目し、5名の講師の方々に切断技術の基礎および最前線を紹介していただきます。

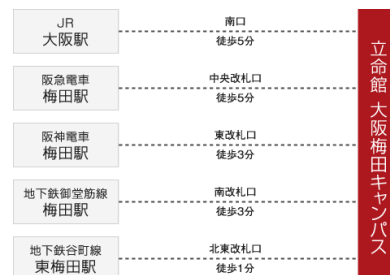
日 時：2017 年 12 月 6 日（水）14:00～17:40

開催場所：立命館 大阪梅田キャンパス（5F 多目的室）

〒530-0018 大阪市北区小松原町 2-4 大阪富国生命ビル 5 階

（立命館 大阪オフィス Tel: 06-6360-4895）

<http://www.ritsumei.ac.jp/osakaumedacampus/access/>



内容：

- 14:00～14:05 開会挨拶 立命館大学 谷 泰弘
- 14:05～14:45 技術講演①「箔電極を用いた半導体 SiC の放電スライシング」 東京大学 国枝 正典 氏
- 14:45～15:25 技術講演②「プラズマエッチングを用いた半導体結晶材料の化学的切断加工」 大阪大学 佐野 泰久 氏
- 15:25～16:05 技術講演③「高速・低損失を実現したレーザスライシングによる SiC ウェーハ製造プロセス：KABRA プロセス」 株式会社ディスコ 平田 和也 氏
- 16:05～16:15 休憩
- 16:15～16:55 技術講演④「進化するタカトリマルチワイヤーと研削装置」 株式会社タカトリ 吉田 寿 氏
- 16:55～17:35 技術講演⑤「半導体パッケージの切断技術」 株式会社 TOWA 高橋 和宏 氏
- 17:35～17:40 閉会挨拶

研究会参加費：10,000 円（当日徴収致します。本専門委員会の賛助会員は3名まで無料です。）

研究会終了後には場所を移し、「技術交流会（会費：5,000 円）」を開催します。（会場は調整中です）

参加申込締切：平成 29 年 11 月 21 日（火）、定員（先着 35 名）に達した時点で締め切らせていただきます。

申込・問合せ先：立命館大学 張 宇

E-mail: zhangyu@fc.ritsumei.ac.jp

Tel/Fax: 077-561-5055

公益社団法人砥粒加工学会 砥粒加工工具を考える専門委員会 第2回研究会参加申込書

氏 名			
勤務先			
参加内容 (参加されるものに○を お付けください。)		研究会（会費：10,000 円）	技術交流会（会費：5,000 円）
連絡先	住所		
	E-mail		
	Tel / Fax		